

* 육상트랙용 우레탄 바닥재(13mm) *

본 시방은 도면에 표기된 육상경기장 트랙용 우레탄 마감공사에 적용하며 뛰어난 탄성과 균열에 대한 견딤성이 우수한 폴리우레탄수지를 주성분으로 한 2액형 도료입니다.

가. 적용범위

1. 육상경기장 트랙 바닥
2. 골프장 주변로 바닥

나. 시 공

1. 바탕처리

- (1) 소지는 충분히 양생되어야 한다. (20℃기준, 30일 이상 양생)
- (2) 콘크리트 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분등 기타 오염물질은 완전히 제거하여야 한다.
(BLASTING, CHIPPING, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCL 산 세척 등)
- (3) 콘크리트 틈새나 흠은 에폭시 퍼티로 메꾸어 주고 적절한 표면조정 후 도장한다.
- (4) 콘크리트 경계 부위에는 V-CUTTING하여 흠을 만들어 준다.
- (5) ASCON 소지의 경우는 균일하게 다짐작업이 되어야 하며, 잔여유분은 물로 3회이상 세척 및 건조한 후 도장하거나 충분히 양생후 시공하여야 한다

2. 도장사양

구분	제 품 명	도막두께	도장방법	색 상	비 고
하도	우레탄 프라이머	50μ	B,R,S	유광, 황색	소지강도보강 및 부착성 향상을 위한 프라이머
중도1	우레탄 연질층 용제살포(기포발생 방지)	4,000μ	RAKE, 헤라 S	유광, 적색외	마모나 충격의 견딤성, 기계적 물성이 우수한 전천후형 탄성 바닥재
중도2	우레탄 연질층 용제살포(기포발생 방지)	4,000μ	RAKE, 헤라 S	유광, 적색외	
중도3	우레탄 반경질층 용제살포(기포발생 방지)	3,000μ	RAKE, 헤라 S	유광 모든색	마모나 충격의 견딤성, 기계적 물성이 우수한 전천후형 탄성 바닥재
상도	우레탄 반경질층	2,000μ	RAKE, 헤라	유광 모든색	마모나 충격의 견딤성, 기계적 물성이 우수한 탄성 바닥재/우레탄 칩
	우레탄 칩	(1,000μ)	살포	모든색	

* 도장방법의 약어 : B => 붓, R => 로울러, S => 스프레이

3. 제품별 도장방법

(1) 하 도

- 바탕처리 후 우레탄 프라이머를 붓,로울러 또는 스프레이로 50 μ 1회 도장한다.

(2) 중도1

- 하도도장 후 20 $^{\circ}$ C에서 최소 5시간 경과한 다음 하도 도막위의 모든 오염물을 제거 하고 도장면적 및 도막두께 4mm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 우레탄 연질층의 주제 와 경화제를 무게비 2.5:1로 혼합한다.
- 스포탄 연질층의 주제와 경화제를 충분히 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하여 총 도막두께 4mm가 되도록 RAKE 끝을 조정하여 긁거나 퍼면서 도포한다.
- 우레탄 연질층 도포 직후 희석제를 살포하여 기포발생을 막아준다.

(3) 중도2

- 우레탄연질층 4mm 도장 후 20 $^{\circ}$ C에서 최소 24시간 경과한 다음 중도1의 방법과 동일한 방법으로 우레탄 연질층을 4mm를 도포한다.
- 우레탄 연질층 도포직후 희석제를 살포하여 기포발생을 막아준다.

(4) 중도3

- 중도 2 도장이 끝난 후 20 $^{\circ}$ C에서 최소 24시간 경과한 다음 도장면적 및 도막 두께 3mm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 우레탄 반경질층의 주제와 경화제를 무게비 2.5:1로 혼합한다.
- 우레탄 반경질층의 주제와 경화제를 충분히 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하여 도막두께 3mm가 되도록 RAKE 끝을 조정하여 긁거나 퍼면서 도포한다.
- 중도3 도포직후 희석제를 살포하여 기포발생을 막아준다.

(5) 상 도

- 우레탄 반경질층의 도장후 20 $^{\circ}$ C에서 최소 24시간 경과한 다음 중도3과 동일한 방법으로 우레탄 반경질층을 도막두께 2mm가 되도록 도포한다.
- 우레탄 반경질층 도장직후 우레탄 칩 (규격 : Φ 3~6mm)을 삼등의 공구를 사용하여 균일하게 살포한다.
- 우레탄 반경질층과 우레탄 칩의 살포작업이 끝나고 20 $^{\circ}$ C에서 최소 15시간 경과한 다음 접착되지 않은 칩을 완전히 수거한다.
- LINE MARKING은 우레탄 상도 무광 주제와경화제를 5:1(무게비)로 혼합하여 에어 스프레이로 50~100 μ 1~2회 도장하여 마감한다.

4. 도장시 주의사항

- (1) 도장 및 경화시 주위 온도는 5 $^{\circ}$ C이상 이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면 온도는 이슬점보다 2.7 $^{\circ}$ C 이상이어야 한다.
- (2) 각 도료는 도장하기전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 고속교반기(RPM 1,000 ~1,500)로 약 4~5분간 균일하게 혼합하여 사용한다.
- (3) 중도 도료는 희석시 경화불량, 물성저하, 기포발생이 되므로 희석하지 않는다.
- (4) 하절기 폭염(28 $^{\circ}$ C 이상의 기온)에서는 표면의 속건으로 인하여 부풀음 현상이 발생되므로 작업을 피하여야 하며, 시공이 불가피한 경우는 오후 5시 이후에 작업하여야 한다.

- (5) 작업 중간에 비가 왔을 경우나 재도장 간격을 넘긴 경우는 층간 부착력이 약해지므로 신나로 전면을 깨끗이 닦아 내거나 우레탄 프라이머를 약 0.1kg/m² 정도 추가 도장한다.
- (7) 우레탄 칩은 우레탄 반경질층을 도포하면서 즉시 살포하여야 접착이 가능하므로 칩 살포시 유의하여야 한다.
- (8) 평활도 향상을 위하여 중도 시공과정 중에 물구배를 잡는 경우에는 반드시 우레탄 프라이머를 추가 도장한다.
- (9) 각 도료는 가사시간을 준수하여 시공한다.
 - 프라이머 : 2시간, 중도 : 30분, 상도 : 30분 (20℃ 기준)